

免清洗针筒锡膏 SY01

SY01 是一款专为针筒点涂工艺设计的免清洗锡膏，适用于人工或自动点膏生产线，具有优良的流变性和稳定的粘度，连续生产不会发生断头、拉尾或坍塌，点涂量均匀可控。SY01 具有极好的可焊性，对铜、锡、镍等金属及其合金界面均有很强的润湿能力，焊后空洞率极低，超过 IPC7095 的Ⅲ级空洞标准(最高标准)，因此 SY01 能保证焊接界面的高结合强度及良好的导热、导电性能，提高产品的可靠性和耐疲劳性。

SY01 的回流窗口宽，能适应多种回流曲线，即使对焊接吸热量大的部件(往往需要延长回流时间以达到需要的温度)，仍然能保持稳定的活性和良好的焊接效果。

虽然焊接活性优异，SY01 的残留物仍然非常安全、稳定，无腐蚀、无色透明，无需清洗。

性能特点

- ☆ 良好的流动性和粘度稳定性，点涂一致性好
- ☆ 润湿性优良，适用于镍、钯等难焊金属
- ☆ 低空洞率，焊接强度高
- ☆ 回流窗口宽，适应多种回流曲线
- ☆ 残留物非常稳定，无腐蚀、无色透明
- ☆ 适用于氮气或空气回流

基本特性

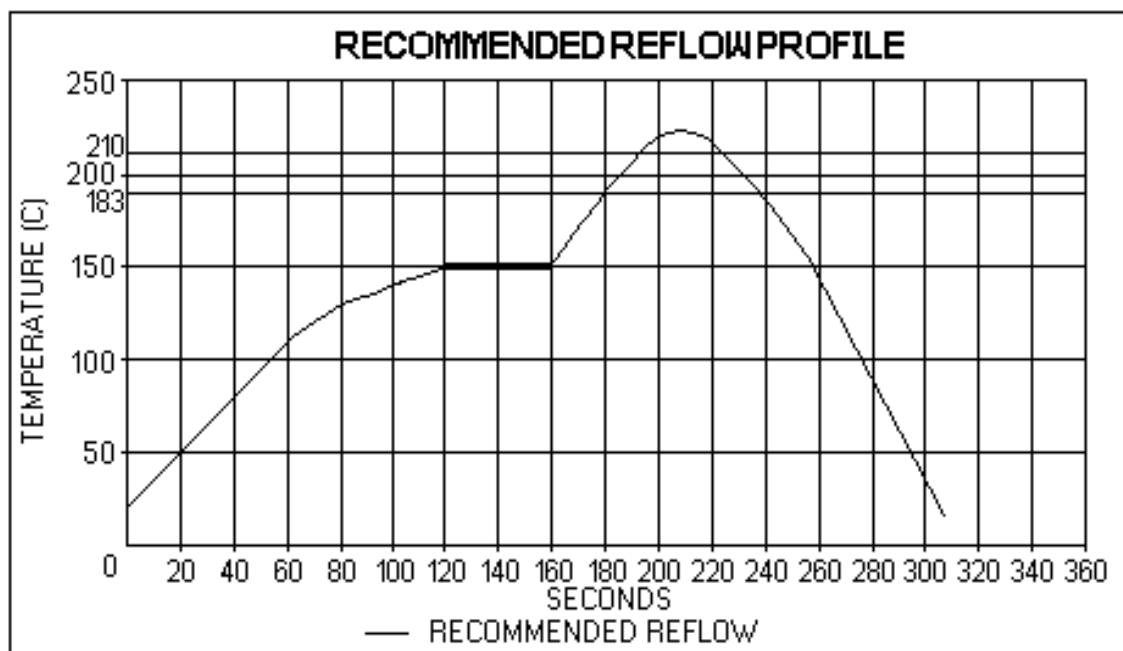
项目	SY01	测试方法
合金成分	Sn63/Pb37 Sn62.8/Pb36.8/Ag0.4 Sn62/Pb36/Ag2	JSTD-006
金属含量	T3: 87% T4: 86.5% T5: 85.5%	IPC-TM-650 2.2.20
粘度	60-90 Pa.s	IPC-TM-650 2.4.34
锡球	极少	IPC-TM-650 2.4.43
扩展率	≥78%	IPC-TM-650 2.4.46
点涂性能(10mm 直针头)	T3: ≤20 号针头 T4: ≤25 号针头 T5: ≤28 号针头	--
使用寿命	>12 小时	@25°C, RH:50%
残留物粘性测试	合格	JIS Z 3284 附件 12

安全性能

项目	SY01		测试方法
铜板腐蚀	合格 (无腐蚀)		IPC-TM-650 2.6.15
铜镜试验	合格 (无穿透)		IPC-TM-650 2.3.32
铬酸银测试	合格 (无变色)		IPC-TM-650 2.3.33
氟化物测试	合格 (无变色)		IPC-TM-650 2.3.35.1
表面绝缘电阻	合格	>10 ⁸ ohms	IPC-TM-650 2.6.3.3
	合格	>10 ¹¹ ohms	Bellcore GR78-CORE
电迁移 (Initial: 65°C/88% RH 96 小时; Final: 10V 500 小时)	合格	Initial=7.6×10 ¹⁰ ohms Final=9.0×10 ¹⁰ ohms	IPC-TM-650 2.6.14.1

回流参数

1. 预热区：以每秒 1-4°C 的升温速率将温度从室温匀速上升至 120°C。
2. 保温区：用 30-60 秒将温度从 120°C 平缓升至 150°C，使 PCB 表面受热均匀。
3. 回流区：用 10-40 秒将温度升至 183°C，高于 183°C 的时间不应少于 60 秒。
用 15-45 秒将温度升至 210-220°C，高于 210°C 的时间控制在 10-30 秒。
4. 冷却区：推荐降温速率 1-2°C/秒。



声明：用户应根据各自的使用目的自行负责判断本资料信息的适宜性。虽然在编写此资料时已足够谨慎，但此资料的准确性和适宜性不对用户的使用或使用结果负责或提供保证。